

第 21 回高温エレクトロニクス研究会

－チップ接合における熱問題－

2011年3月2日(水) 13:30-16:30
JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパスA棟2階大会議室
＊事前登録不要・参加費無料

第21回高温エレクトロニクス研究会を JAXA 宇宙科学研究所相模原キャンパスにて開催いたします。
皆様の参加をお待ちしております。

プログラム

(敬称略, 各講演質疑応答含めて 30 分)

■13:30-13:40

はじめに

小林大輔 (宇宙研)

■13:40-14:10

SiC用高温Au-Geダイボンドと
その信頼性評価

谷本智 (次世代パワーエレクトロニクス
研究開発機構/日産自動車)

■14:10-14:40

フリップチップ実装構造における
局所残留応力・変形の発生と
構造信頼性への影響

中平航太 (東北大学)

■14:40-15:10

極低温アレイ型遠赤外線検出器のための
Auバンプ技術

川田光伸 (宇宙研)

15:10-15:30 休憩

■15:30-16:00

はんだの熱疲労寿命評価法

坂根政男 (立命館大学)

■16:00-16:30

有限要素法を用いた
熱・振動複合環境下における
はんだ接合部の疲労寿命評価

松嶋道也 (大阪大学)

本年度のテーマ

電子デバイスを高温環境で利用するには、デバイス自身の耐熱性のみならずパッケージングの熱信頼性を確保することが重要な課題です。本年度はそのパッケージング工程の中でもチップ接合について焦点を当てました。チップをリードフレームなどの基板に接合するためのダイボンドや、ボンディングワイヤの半田接合、マルチチップ接合などについてです。この分野の第一線の方々に、これらにおける熱的問題の物理機構から評価法まで幅広く御講演いただきます。

高温エレクトロニクス研究会とは

高温エレクトロニクス関連分野は、宇宙をはじめとして、パワーデバイス、カーエレクトロニクス、資源探査、原子力等の広い領域に渡ります。本研究会は、このような高温エレクトロニクスのシステム・デバイス・材料に関する技術の現状を把握するとともに、その新しい応用分野を開拓することを目的として、広い層の研究者・技術者相互の交流を促進するよう、毎年開催されています。

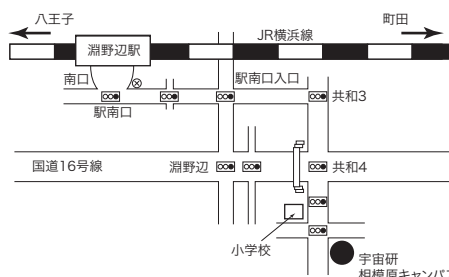
■事前登録 / 参加費

事前登録は不要です。また、参加費は無料です。

■問い合わせ先

JAXA 宇宙科学研究所 宇宙探査工学研究系
准教授 廣瀬和之, 助教 小林大輔
〒252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1
050-3362-3126 hte@isas.jaxa.jp

■最寄り駅から相模原キャンパスまでのご案内



JR 横浜線淵野辺駅
南口より徒歩 20 分

会場 (A 棟) は
入り口正面の建物に
なります